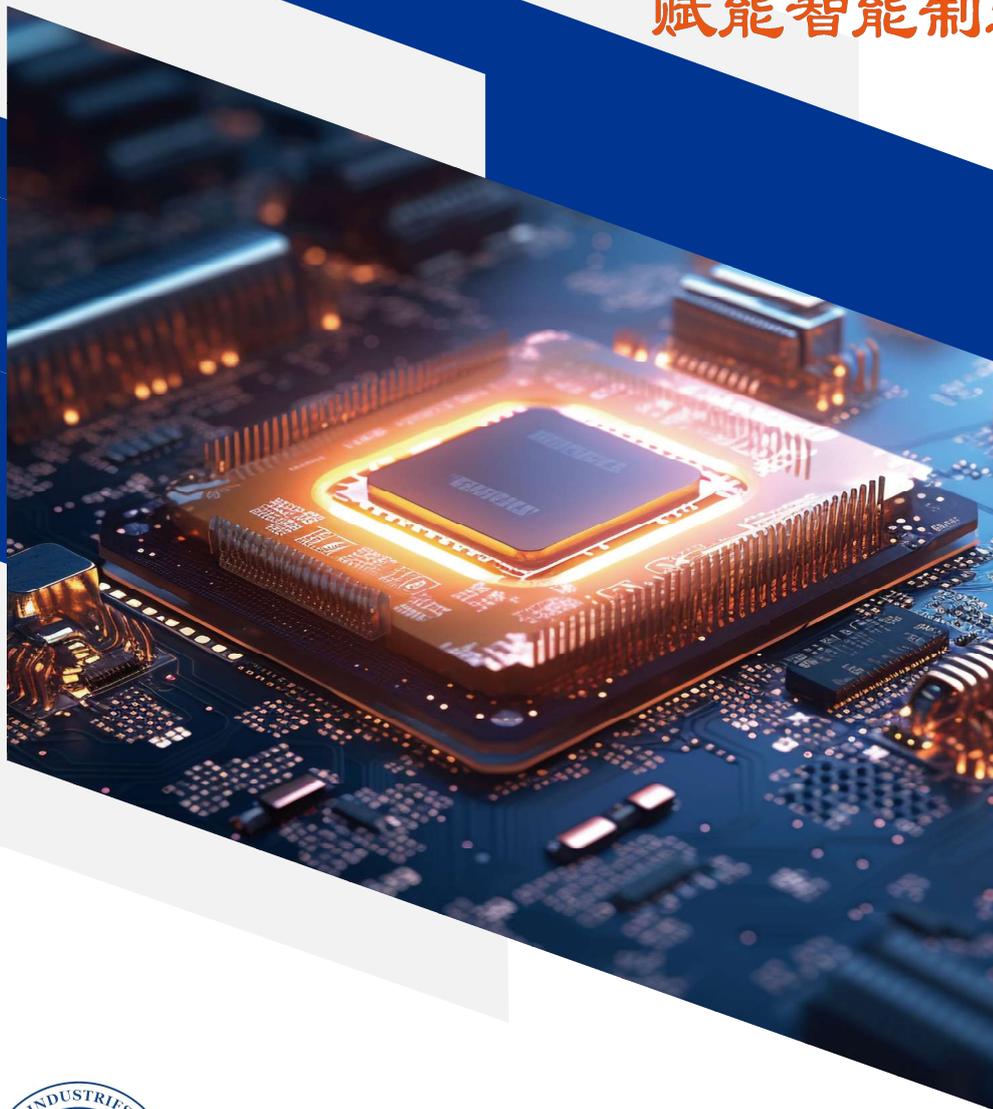


聚焦国芯
赋能智能制造产业



中芯博览
ZHONGXIN EXPO

2024世界芯片产业链博览会暨峰会

2024 WORLD CHIP INDUSTRY CHAIN EXPO & SUMMIT

2024年10月15-17日 深圳会展中心（福田）

4万展会面积 + 9场行业论坛、声势浩大、万众瞩目

组织单位

指导单位 深圳市人民政府

深圳市工业和信息化局

深圳市商务局

主办单位 深圳市电子行业协会

CIRI芯片产业研究院

中芯博览(深圳)科技有限公司

协办单位 新一代信息技术专业委员会

汽车电子专业委员会

电子封装材料专业委员会

电子元器件专业委员会

电子行业标准专家委员会

前海方舟电子科创产业基金

深圳电子产业战略投资基金

承办单位 中芯博览(深圳)科技有限公司



大会背景

400+
参展商

40000+
展会面积

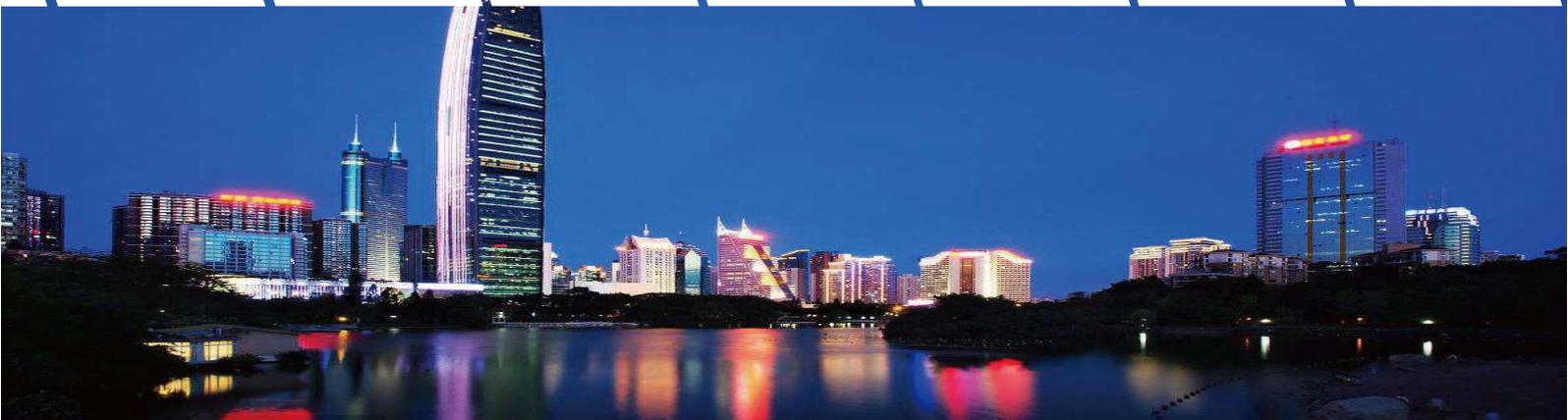
100000+
观众

1场
主题论坛

2场
圆桌对话

6场
专题论坛

1000+
参会人员



政策指引

芯片作为现代化电子产业的核心以及国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业。“集成电路”和“芯片”在全国两会时光中热度不断，众多“芯”声释放出国家战略与产业信号，预计到2024年底芯片市场规模将突破千亿元。

地域优势

深圳作为我国规模最大、整体水平最高的电子信息产业的重要基地之一，是全国具影响力的芯片应用市场。

正因此，深圳也聚集了众多海内外芯片产业客商与投资者。大会选址深圳，依托深圳深厚技术沉淀，与繁荣的芯片贸易市场，为参会企业与客商提供一个技术交流、产品展示、贸易洽谈的全方位平台。

权威背书

2024世界芯片产业链博览会暨峰会，荣获深圳市人民政府、深圳市电子行业协会与CIRI芯片产业研究院等单位的支持主办；数千家会员单位鼎力支持；上百家权威媒体共同发声；“展+会+赛”三大权威盛会结合，致力于打造唯一涵盖产业和应用的专业博览会，搭建全球芯片产业和应用领域顶级对话与合作平台。

4大展区



人工智能芯片展区

- ◆ 车规级芯片、驱动芯片、交通电子芯片等；
- ◆ 消费电子芯片、医疗芯片显示芯片、计算机及控制芯片等；
- ◆ 物联网芯片、5G芯片、通信芯片、存储器芯片等；
- ◆ 电源管理芯片、电器芯片等、LED照明及显示驱动类芯片等；
- ◆ 传感器芯片、音视频&图像处理芯片、半导体芯片、光芯片等；



芯片制造材料与设备展区

- ◆ 单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石英制品、防静电材料、纳米材料等；
- ◆ 第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件等；
- ◆ 半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备等；
- ◆ 单晶炉、氧化炉、离子注入设备、PVD、CVD光刻机、蚀刻机、倒角机、热加工、涂布设备等；



芯片设计与先进封测展区

- ◆ IC及相关电子产品设计
- ◆ SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板等；
- ◆ 印制电路板、封装基板和设备及组装和测试等；
- ◆ 封装设计、测试、设备与应用制造与封测等；
- ◆ EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备等；



芯片终端应用创新成果展区

- ◆ 物联网、人工智能、汽车电子等；
- ◆ 智能终端、智能云计算、智慧城市等；
- ◆ 医疗健康、工业应用等；

第二届世界芯片产业链峰会

1场 高峰论坛

2场 领袖对话

6场 专题论坛

1场 颁奖晚宴

100+ 演讲嘉宾

1000+ 专业听众

- 01 闭门会议 TOP“芯领袖”企业家战略研讨会
- 02 高峰论坛 IC产业“芯”技术 “芯”策略 “芯”未来
- 03 领袖对话 突破壁垒——“芯”时代下、高端芯片制造技术突破
- 04 领袖对话 聚焦应用——智能芯片走入各行各业
- 05 专题论坛 新型半导体材料与半导体设备论坛
- 06 颁奖晚宴
- 07 专题论坛 IC设计与先进封测技术创新论坛
- 08 专题论坛 人工智能芯片创新应用与发展论坛
- 09 专题论坛 汽车芯片技术突破与应用论坛
- 10 专题论坛 芯片产业环保解决方案论坛
- 11 专题论坛 资本东风——高端芯片产业链投融资论坛

拟邀嘉宾



罗毅

中国工程院院士
清华大学电子工程系
教授



陈锐志

芬兰科学与人文院
院士、武汉大学教授



倪光南

中国工程院院士



张卫

复旦大学微电子学院
院长



吴汉明

中国工程院院士
研发高密度等离子体
刻蚀



戴琼海

中国工程院院士自动
控制学家、清华大学
信科学院院长



魏少军

应用科学博士、现任
清华大学教授



林祥峰

深圳市电子行业协会
执行会长



叶甜春

中国半导体行业协会
副理事长



罗镇球

台积电(南京)有限公
司总经理



陈杰

紫光集团董事
哈尔滨工程大学学士



何庭波

华为董事
华为科学家委员会主任
ITMT主任、海思总裁



张雪娜

埃芯半导体创始人、
董事长、CTO



应为民

华为投资控股有限
公司董事、首席供应官



高滨

清华大学微电子与纳电
子学系副教授



张砚霖

中投顾问执行董事
中投顾问产业研究中心
研究总监



肖智轶

复旦大学博士
华天集团副总裁



尹首一

清华大学集成电路学院
教授，已发表学术论文
200余篇

同期活动

■ 2024世界MEMS与传感器博览会暨峰会

■ 2024世界功率半导体产业链博览会暨峰会

■ 2024世界高效热管理材料与设备博览会暨峰会



颁奖典礼

2024全球“芯”领袖贡献奖

2024全球芯片领军企业奖

2024全球芯片创新设计奖

2024全球芯片先进技术奖

2024全球芯片封测技术奖

2024最佳芯片产业分销商奖



展会亮点

- » 国家协会鼎力支持、权威机构重磅加盟
- » 汇聚众多国内外专家、行业领袖、资深投资人
- » 1000+产业集群，促进生态链交流合作对接
- » 行业难题头脑风暴、尖端创新技术共享
- » 专业观众渠道、一对一精准对接
- » 央媒及电视台助力、亿万级曝光引流

合作媒体



参展详情



标准展位：10800元/个
展位规格：9m²（3m x 3m）

注：双面开口另增加20%费用

展位配置：
加大写真帽牌、9平方米地毯、资料台1张
椅子2把、10A/220V单相插座1个、纸篓1个
射灯2支、保洁及保安服务。

特装展位：1080元/m²
展位规格：36m²起订

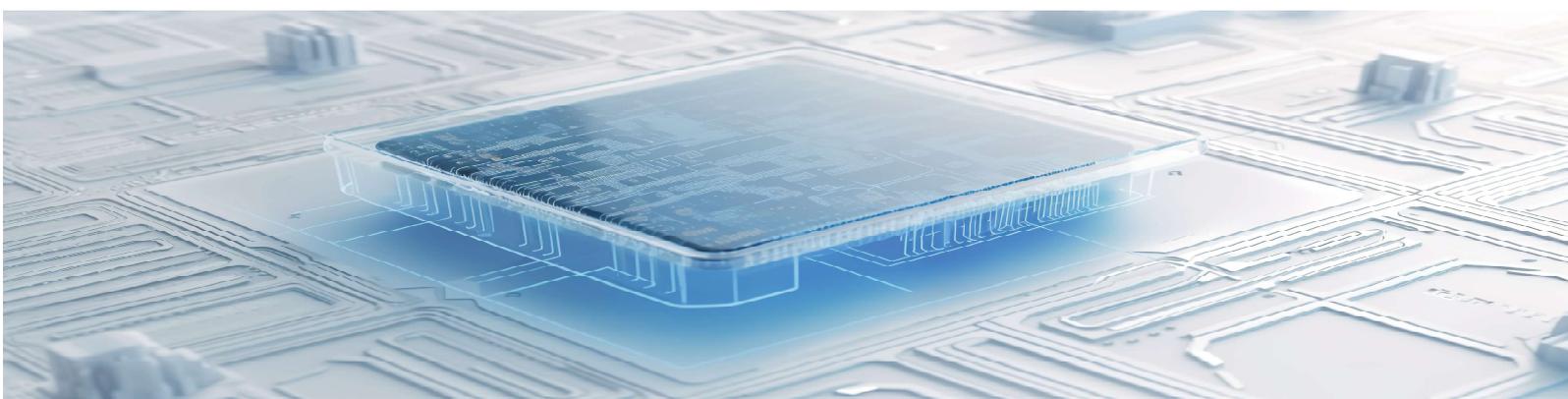
注：
特装空地由参展企业自行设计搭建，
或选用组委会推荐特装搭建商设计搭建
为了整体效果，特装展台高度不宜超过4.5米。

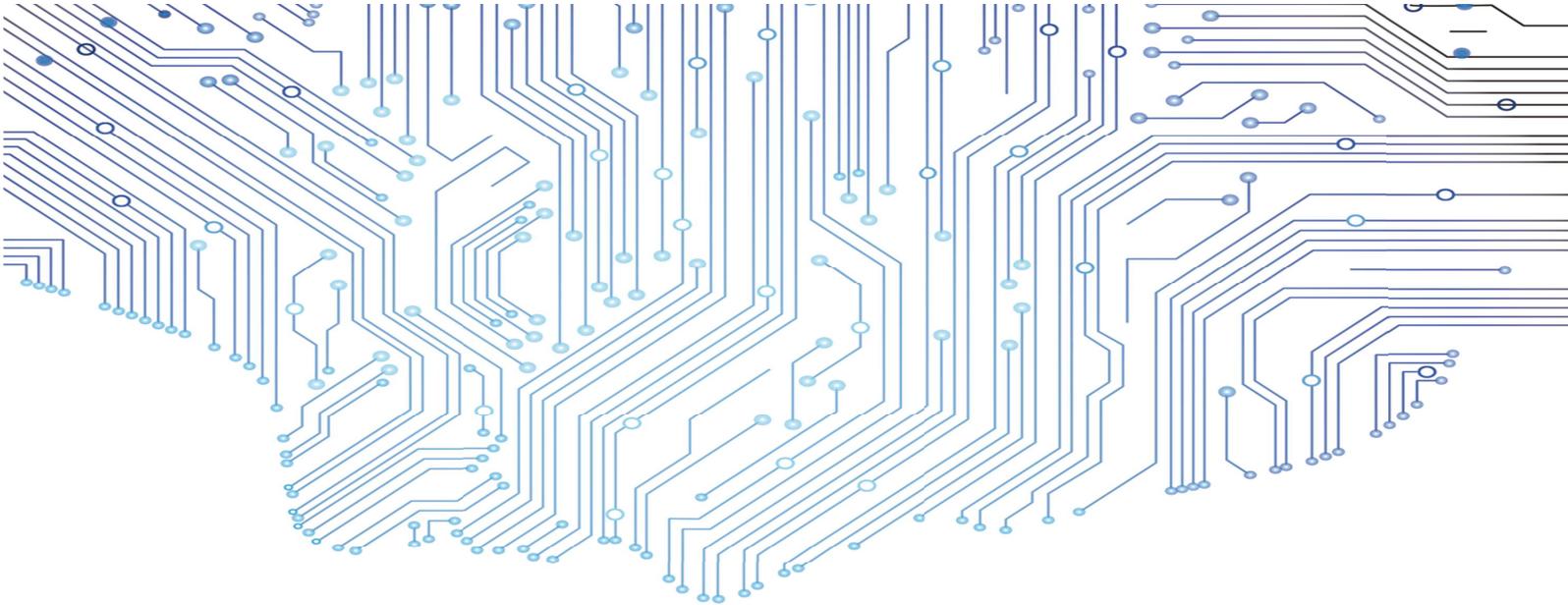


大会赞助

大会赞助	费用标准	参考图片	大会赞助	费用标准	参考图片
总冠军	50万		茶歇赞助 (2天独家)	4万	
特级赞助	30万		道旗广告 桌旗广告 桁架喷绘广告	3万	
颁奖晚宴冠名	20万		胸牌广告 吊绳广告 (独家)	3万	
主论坛演讲	6万		主论坛侧屏广告 大会礼品广告 (资料袋、饮用水)	2万	
领袖对话	5万		会刊广告	封面: 2万元 封底: 1.5万元 扉页: 1万元 封二: 9000元 封三: 8000元 内页: 6000元	
分论坛演讲	3万				

具体赞助项目包含权益内容，咨询组委会





www.smicexpo.com

详情咨询组委会

张默

173 2235 7895 (微信同号)

176 1219 8673 (微信同号)



扫码关注我们
实时解锁最新动态